

2026 年 2 月 13 日

各 位

上場会社名 メック株式会社
代表者 代表取締役社長 前田 和夫
 (コード番号 4971 東証プライム市場)
問合せ先責任者 コーポレートコミュニケーション課 松下 綾
 (TEL 06-6401-8160)

中期経営計画（2025 年～2027 年）数値目標更新に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 2 月 14 日に公表しました「2030 年ビジョン Phase 2 中期経営計画（2025～2027）」について、数値目標を更新することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 修正の内容

数値目標（連結）

	当初目標 2027 年 12 月期	更新後の目標 2027 年 12 月期	実績 2025 年 12 月期
売上高	25,000 百万円 コア事業 23,500 百万円 応用展開 1,500 百万円	25,000 百万円 コア事業 24,500 百万円 応用展開 500 百万円	20,947 百万円
営業利益率	20%以上	26～30%	27.4%
ROE	10%以上	13～16%	17.5%

2. 修正の理由

当社は、2025 年 2 月 14 日、2025 年度を初年度とする「2030 年ビジョン Phase 2 中期経営計画（2025～2027）」を公表し、2030 年ビジョン「界面の創出と接合で世界一になる」を掲げ、「創造と変革」を指針に事業活動に取り組んでおります。

社会がデジタル化やグリーン化に向けた変革期にある中、当社グループが属する市場環境および高付加価値製品の需要動向を踏まえ、経営目標をより明確にすべく、数値目標を更新することといたしました。

売上高目標につきましては、コア事業において、生成 AI に関連する半導体パッケージ基板の需要が想定を上回っており、関連する製品の売上見通しを上方修正いたしました。応用展開では、コア事業で培った製品技術を活用し、新領域での事業機会獲得を目指し取り組みを進めておりますが、新技術の立ち上がりが当初想定よりも後ろ倒しとなる可能性があることから、下方修正を行いました。

営業利益率目標につきましては、当社グループが属する市場環境および高付加価値製品の需要動向から従来目標を上回る水準を見込んでおりますが、2026 年 12 月の稼働開始を予定している福岡県北九州市の新生産拠点において、立ち上げに伴う初期費用や減価償却費の増加が見込まれます。これらの要因を総合的に勘案し、目標値を更新いたしました。

なお、本更新は戦略方針の変更を伴うものではなく、既存の中期経営計画の枠組みの中で、数値目標の見直しを行うものです。

引き続き、当社グループを取り巻く経営環境の変化に適時適切に対応するとともに、「独創の技術」「信頼の品質」「万全のサービス」を信条に、界面価値創造の実現と持続可能な企業価値向上に努めてまいります。

詳細につきましては、添付資料をご参照ください。

なお、発表資料における将来に関する記述は、発表日現在に入手可能な情報に基づき作成したものであり、将来の業績を保証するものではありません。実際の業績・結果は、今後の様々な要因により業績等が変動する場合があります。

以 上

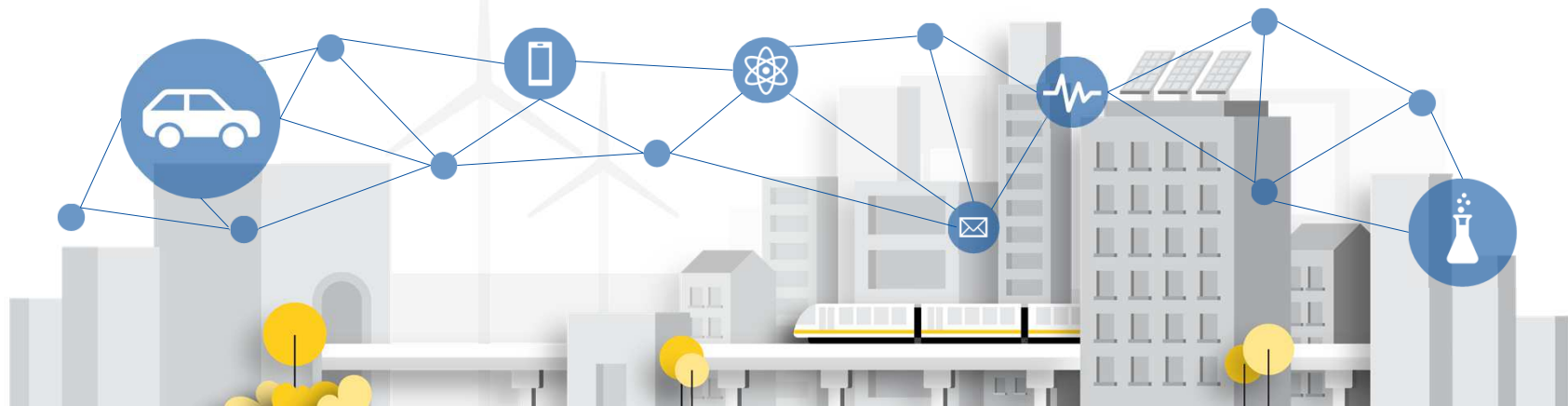
2030年ビジョン

Phase 2 1年目の進捗と今後の取り組み

中期経営計画

(2025-2027)

2026年2月13日

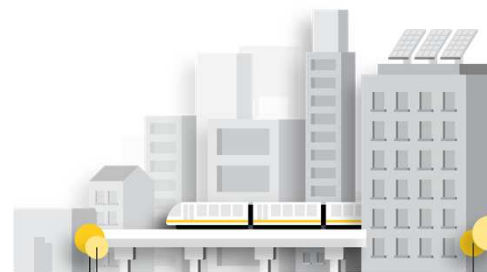


1 2030年ビジョン

2 中期経営計画 Phase2 数値目標見直し

3 中期経営計画 Phase 2

- ① 定性および定量目標
- ② 資本政策
- ③ 人財開発
- ④ 持続可能な社会に向けて



- 生成AI関連の需要拡大など好調な市場環境を背景に
「2030年ビジョンPhase 2」1年目の業績は当初想定を上回って推移
- 市場環境と高付加価値製品の需要動向を踏まえ、
Phase2最終年度である**2027年12月期の目標を修正**
 - ・ 売上高 250億円 ⇒ 250億円
 - コア事業 235億円 ⇒ 245億円
 - 応用展開 15億円 ⇒ 5億円
 - ・ 営業利益率 20%以上 ⇒ 26～30%
 - ・ ROE 10%以上 ⇒ 13～16%
- さらなる株主還元の強化を図るため、Phase 2における**配当方針を**
「**連結配当性向35%以上かつ連結株主資本配当率（DOE）4.0%以上**」に変更

なお、本更新は戦略方針の変更を伴うものではなく、
既存の中期経営計画の枠組みの中で、数値目標の見直しを行うものです。

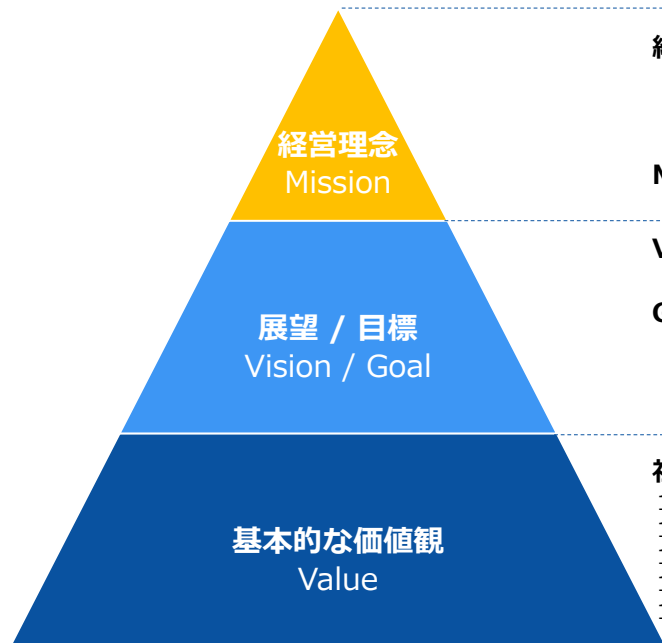
1

2030年ビジョン



社是 (Company motto)

仕事を楽しむ



経営理念：わたしたちは「独創の技術」「信頼の品質」「万全のサービス」を信条に、自由に着想し、グローバルな事業活動を通して界面価値創造を実現することで豊かで潤いのある社会と環境づくりに貢献します

Mission：界面から、世界を変える

Vision：界面の創出と接合で世界一になる

Goal：ありたい姿の実現

- ・ 真のグローバルカンパニーになる
- ・ 研究開発型企业であり続ける
- ・ 独創のAI企業としての顔を持つ

社訓

1. 失敗を恐れず常に新しい目標に挑戦しよう
1. 飽くなき好奇心で工夫改善を重ねよう
1. 協調と感謝の気持ちで力を合わせ仕事を進めよう
1. 安全と健康に気を配り楽しい職場を作ろう
1. 広く社会に役立つことを心掛けよう

創造と変革

「つくる」を変える、「うる」を変える

人の“わ”を重んじ、唯一無二の価値を育む
社外への人の輪と、社内への人の和。
価値を育むのは人である



企業像

- 独創の技術で新たな価値を創造する真のグローバルカンパニーになる
- 研究開発型企业であり続ける
- 独創のAI企業としての顔を持つ



人財像

- 各自自立自走し、連帯できる人財を目指す
- 熱意を持ち、挑戦を続ける人である
- 基本的なデジタルリテラシーを持つ



組織

- 役割に応じて優秀な人財の確保を行い、適正に配置し、十分に活躍できる環境を準備するよう最善を尽くす

事業活動を通じ、社会課題解決に貢献できる製品・技術を世に提供します。

事業

- 未来を切り開く研究開発
- 環境負荷低減製品の開発
- 適正の調達、生産、物流



環境

- 気候変動対応
- 適正な化学物質管理
- 資源循環の推進
- 品質保証



社会・労働

- 労働安全・健康経営
- ワークライフバランス
- キャリア形成
- ダイバーシティ
- エンゲージメント



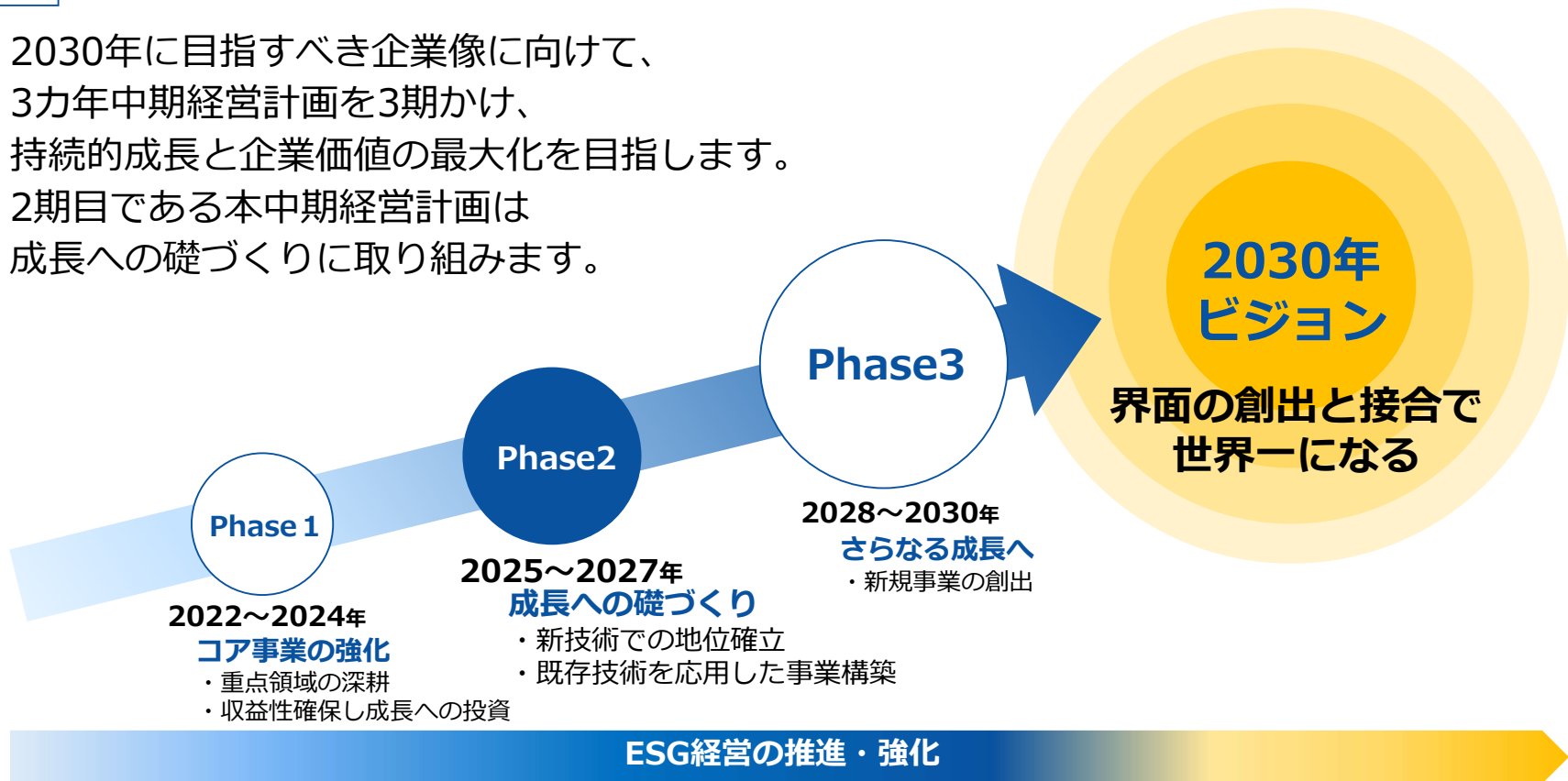
ガバナンス

- コーポレート・ガバナンスの強化
- リスクマネジメント強化
- コンプライアンスの徹底
- 情報セキュリティ



本中期経営計画の位置づけ

2030年に目指すべき企業像に向けて、
3力年中期経営計画を3期かけ、
持続的成長と企業価値の最大化を目指します。
2期目である本中期経営計画は
成長への礎づくりに取り組みます。



通信情報革命により、デジタル技術が急速な発達が見込まれています。



**次世代通信
ネットワーク**

5G/6G、光通信、衛星通信



IoT

あらゆるものがネット接続



AIの多様化

情報処理に人工知能を応用、DX、ロボット



次世代モビリティ

自動運転車、自動運転アシストシステム

2

中期経営計画 Phase2 数値目標見直し



当社グループが属する市場環境と当社高付加価値製品の需要動向を踏まえ、収益性および資本効率に関する経営目標を明確化します。

	2025年12月期 実績	2027年12月期 当初目標	2027年12月期 修正目標
売上高	209億円	250億円 コア事業 235億円 応用展開 15億円	250億円 コア事業 245億円 応用展開 5億円
営業 利益率	27.4%	20%以上	26～30%
ROE	17.5%	10%以上	13～16%

3

中期経営計画 Phase2



拡大する市場



次世代通信ネットワーク

(5G/6G、光通信、衛星通信)



IoT

(あらゆるモノがネット接続)



AIの多様化

(DX、エッジAI、ロボット、医療等)



次世代モビリティ

(自動運転車、運転アシストシステム等)

コア事業の**市場拡大**
(半導体、電子基板市場)

求められる技術



高速情報処理



低電力消費



小型化



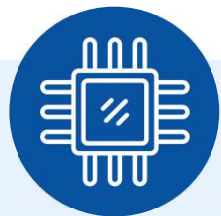
信号低損失



高集積二一ス拡大

超微粗化、無粗化技術による
密着向上剤の需要拡大
(信号高速化、高密度化)





半導体パッケージ (コア事業の拡大)

信号低損失、高集積化による
適用技術の変化

最終製品例

データセンター、通信インフラ、ロボット、
パソコン、車載等



高速・情報通信 (新技術領域の開拓)

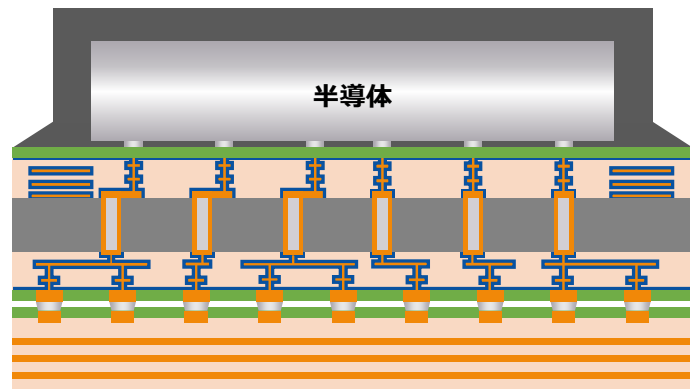
信号低損失、高集積化による
適用技術の変化

最終製品例

データセンター、通信インフラ、ロボット、
パソコン、車載等

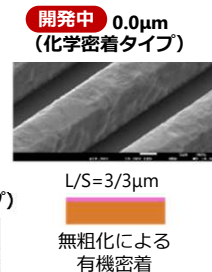
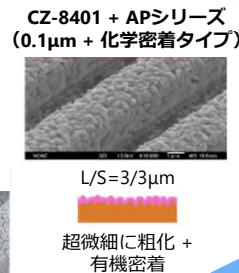
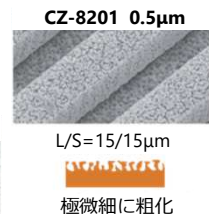
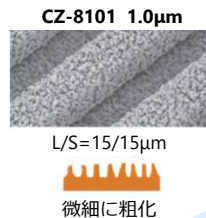
当社の強み 層間密着技術

主力製品「CZシリーズ」は、銅と樹脂との密着が求められる界面で貢献しています。
半導体パッケージ基板の銅とビルドアップ樹脂との密着向上プロセスで欠かせない技術です。



- CZシリーズが使用される場所
- 銅
- ソルダーレジストインク
- 樹脂

半導体パッケージ基板が大型化・高多層化
⇒ CZシリーズの使用量増加

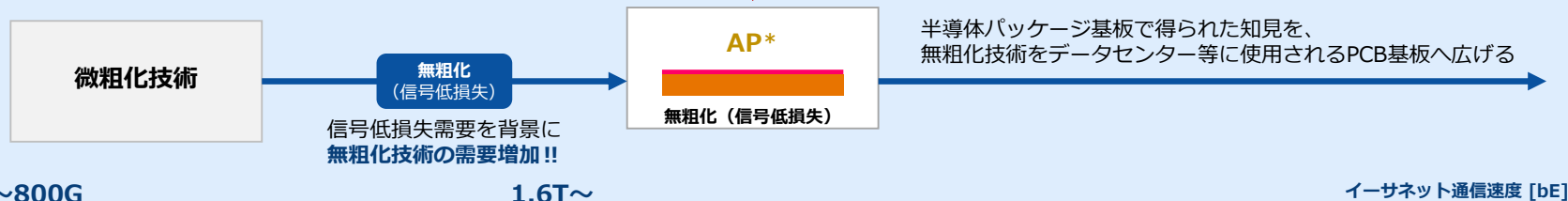


より低エッチングに

コア事業：半導体パッケージ基板



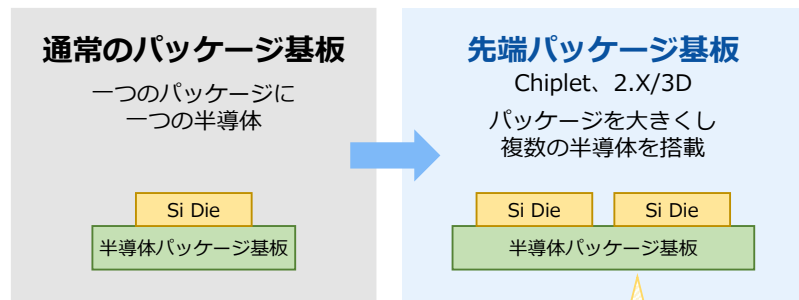
応用展開：PCB基板（高周波基板）



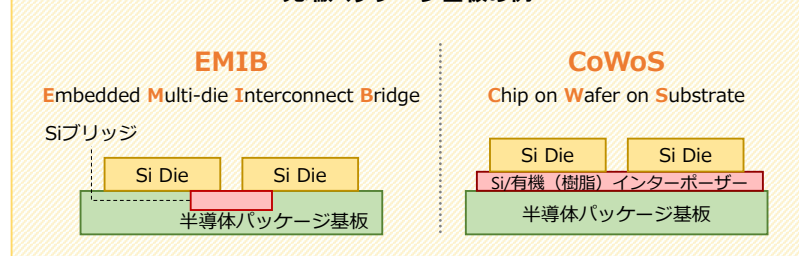
コア事業：半導体パッケージ基板の既存領域における取り組み MNEC

半導体パッケージ基板の進化によって当社製品の使用量の増加を見込みます。

半導体パッケージ基板を取り巻く流れ



先端パッケージ基板の例



当社の取り組み

豊富な製品ラインナップを活かして先端
半導体パッケージ基板の課題を解決する製品を提供

CZ・APシリーズで課題を 解決

半導体パッケージ基板の

- 高密度化
- サイズ大型化
- 高多層化

APシリーズ

CZ-8401

CZ-8201

CZ-8101

化学密着

機械密着

技術サポートを通じて適切な製品を顧客に提案



顧客企業

課題を解決する製品提案

定期的なコンタクトによる
課題把握



当社
技術サポート

応用展開：高周波基板における取り組み

高速通信の進展を背景に、高周波特性を備えた基板の成長を見据え、次世代技術における技術優位性の確立に向けた製品開発を推進します。

高周波基板を取り巻く流れ

現在の主流

800ギガイーサネット



データトラフィックの増加に伴う
データ処理の高速化の必要性

2027年以降に本格的な立ち上がりの見込み

1.6テライーサネット



電気信号を高速化し、
データ処理の高速化を目指す

現状の技術

銅の表面を
粗化

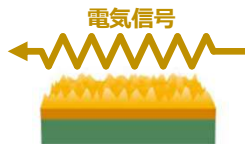


有機被膜で
銅と樹脂を密着

● 技術的な課題

銅表面に粗化による凹凸があるため

△ 伝送損失が
大きい



当社が目指すこと

APシリーズ

有機被膜のみで銅と樹脂を密着

● 開発の方向性

- ・表面処理のロス低減
- ・多様な基材・プロセスに使用できる汎用性の向上

OEMや顧客からの評価による改善を進める

● 期待できる効果

銅表面に粗化による凹凸がないため

○ 伝送損失が
小さい

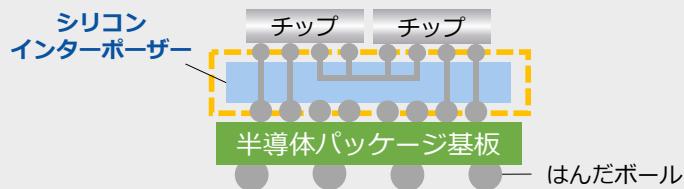


応用展開：インターポーターにおける取り組み

大型化・高密度化の進展を背景に、インターポーターの構造変化を見据え、次世代技術における技術優位性の確立に向けた製品開発を推進します。

インターポーターを取り巻く流れ

現在はシリコンインターポーターが主流



製造コストの削減に向け
有機材料（樹脂）の
インターポーターの
開発が進展

処理能力増に向けた
大型化が進展

銅と樹脂の密着度が高い
当社製品が貢献できる領域の拡大

当社の取り組み

既存製品を活用してインターポーターの進化に
対応するための製品開発を推進

CZ・APシリーズで課題を
解決

インターポーターの
樹脂化・大型化に伴い
「反り」が発生

APシリーズ

化学密着

CZ-8401

機械密着

その他、当社技術の参入機会の可能性に向けた取り組み

JOINT3

次世代半導体パッケージのコンソーシアム
「JOINT3」に参画

目的

参画企業との共創により、パネルレベル有機インターポーターに
適した材料・装置・設計ツールの開発を加速

メックの役割

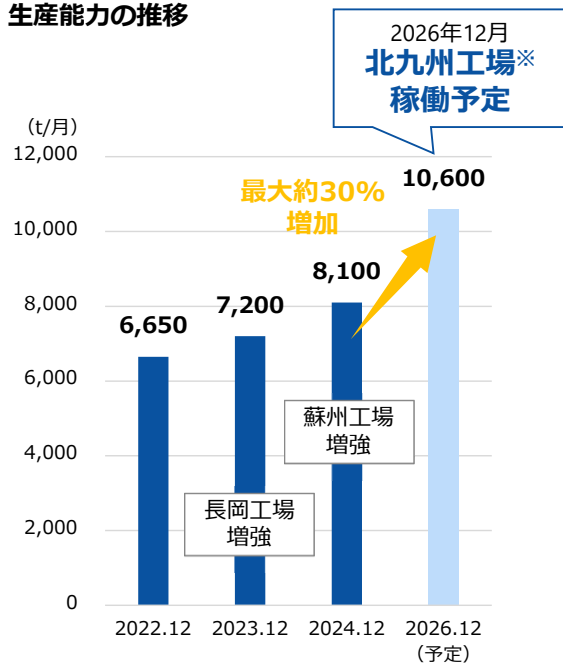
層間密着強化による高集積化への貢献等

参画企業

27社（2025年9月3日時点）

今後の当社製品の需要増加を見据え、安定供給体制を強化します。

生産能力の推移



北九州工場※の概要

生産能力を増強し、CZシリーズに加え、APシリーズの量産にも対応

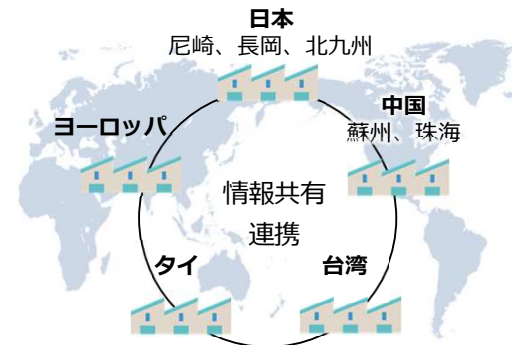


(イメージ)

- 2026年12月稼働予定
- 総投資額は約47億円（土地含む）
- 最大生産能力は、年間3万トン予定
- 地政学リスクが高まるなかサプライチェーンの安定にも寄与

グローバル生産体制の強化

従来、各生産拠点視点で構築していた目線をメックグループとして最適化し、グローバル視点での生産体制を強化する



主力製品の今後の見通し

		特徴	最終製品例	売上見通し	
密着向上剤	APシリーズ (化学密着タイプ)		- データセンター - 通信基地局 - 自動運転車 - 電気自動車 - ロボット - パソコン - スマートフォン - タブレットPC		
	CZシリーズ	CZ-8401		- 銅表面に低エッチングによる独特の凹凸形状を形成し、銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。 - 主に半導体パッケージ基板向けの密着向上剤で、高密度PCB基板にも使用される。	
		CZ-8201			
		CZ-8101			
		CZ-8100			
	V-Bondシリーズ		- 自動車 - スマートフォン - 衛星通信		
エッチング剤	EXEシリーズ		テレビ・スマートフォン等のディスプレイ		
	SFシリーズ		タブレットPC		

3

中期経営計画 Phase2

① 定性および定量目標



定量目標

連結売上高

2027年

250億円

コア事業 245億円
応用展開 5億円

連結営業利益率※

26～30%

ROE※

13～16%

定性目標

既存市場における収益性維持・強化

- 顧客との関係性強化
- 超微粗化系密着向上処理のシェア維持
- 無粗化技術（化学密着）領域におけるソリューション確立
- 環境配慮薬品への取り組み

既存技術の応用展開分野における事業構築

新規事業の創出

グローバル安定供給体制の確立

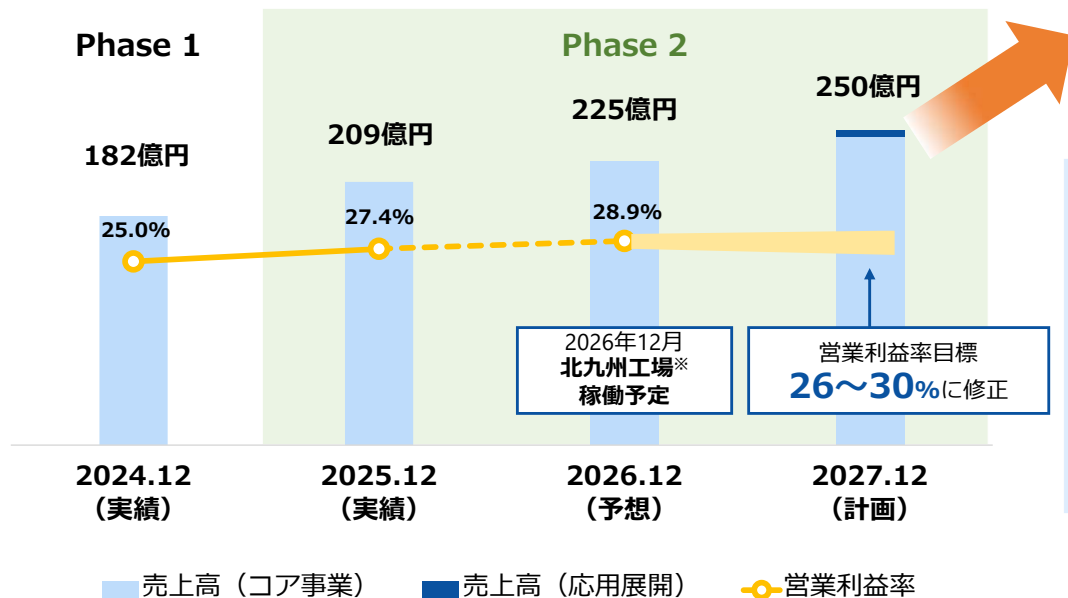
ESG経営の推進・強化

※2026年2月13日に目標を修正

2030年ビジョン達成に向けたロードマップ

半導体市場の拡大に伴う旺盛な需要に対応するため、
新技術領域開拓および生産能力増強を行い、中長期の飛躍を目指します。

売上高・営業利益率の実績と計画



さらなる
**トップライン成長と
利益率向上**の実現を目指す

営業利益率目標変更の理由

- 生成AI関連の需要拡大に伴い高付加価値品の需要が拡大。
- 半導体関連の需要は旺盛で、今後も堅調な需要が見込まれる。

北九州工場※稼働による費用増加

- 2027年12月期は試験運用や立上げ対応のため費用の先行発生を見込む

3

中期経営計画 Phase2

② 資本政策



株主還元方針の変更

より安定的な配当と株主還元の強化を図るべく配当方針を変更し、自己株式取得は、従来どおりキャッシュ・アロケーションの進捗などを踏まえながら機動的に実施します。

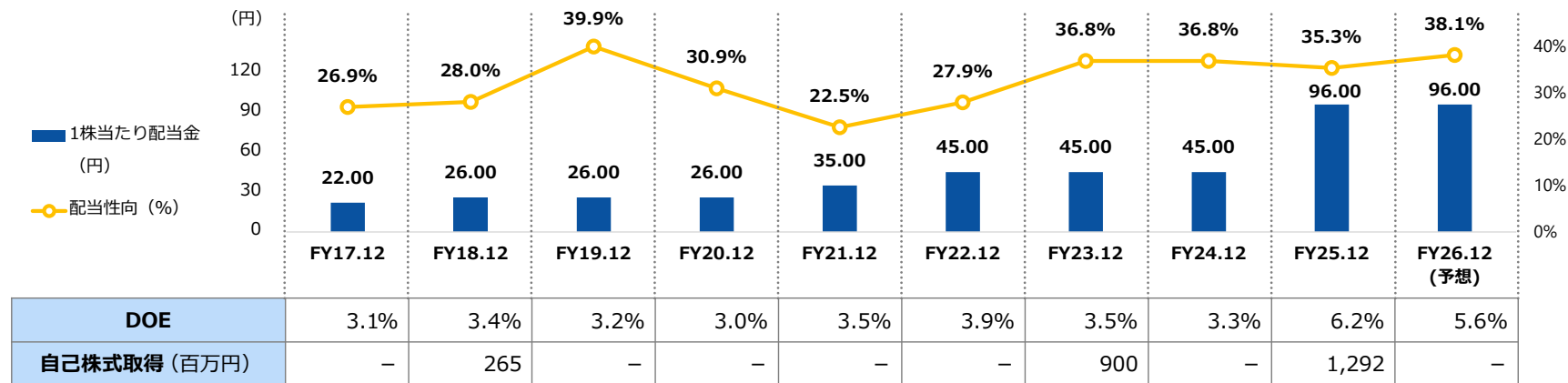
変更前

1株当たり年間配当金の維持・成長
連結配当性向：30%目標

変更後

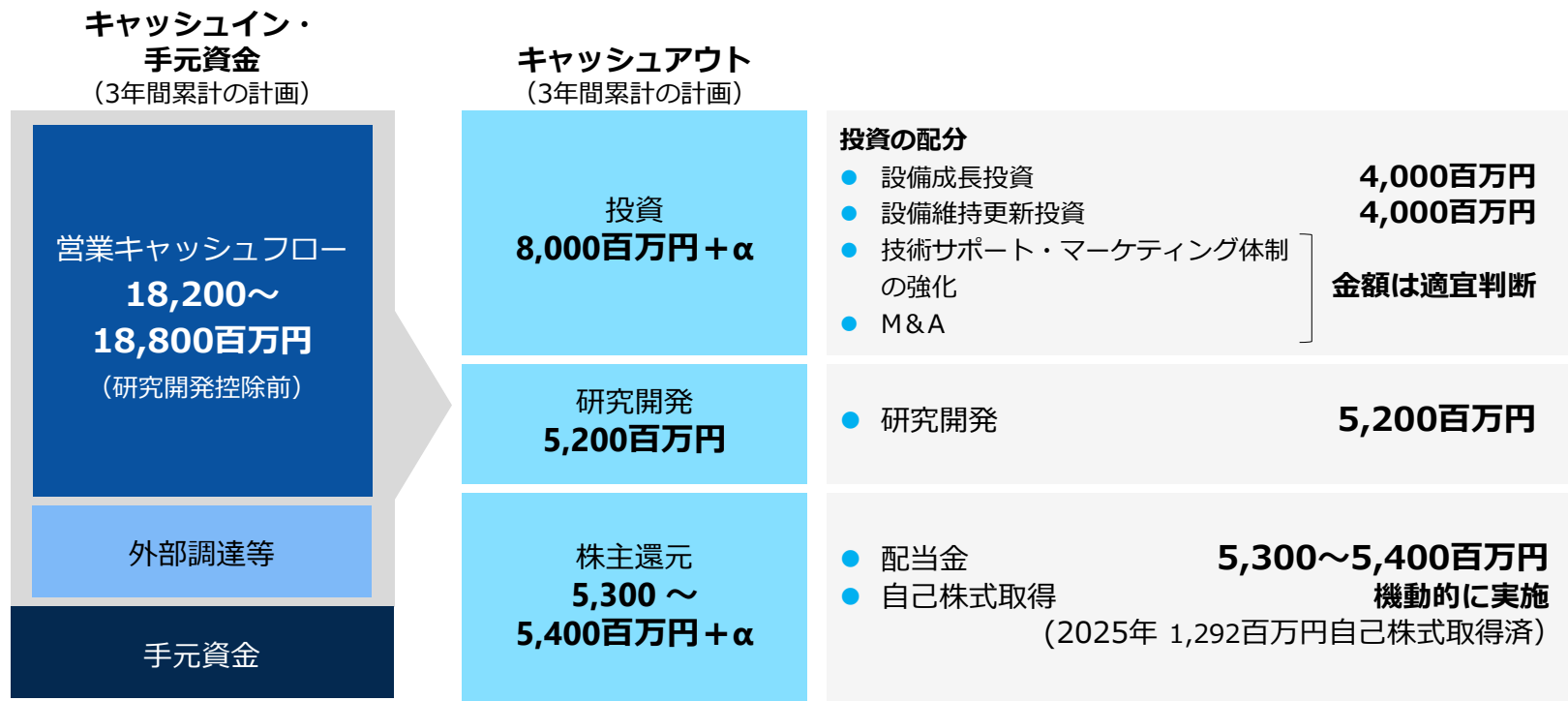
連結配当性向35%以上 かつ
連結株主資本配当率（DOE）4.0%以上

配当金および配当性向の推移



キャッシュ・アロケーション 基本方針

Phase2（2025～2027年累計）のキャッシュ・アロケーションの基本方針を示します。



※各項目の大きさはその額の大きさを示すものではありません。

3

中期経営計画 Phase2

③ 人財開発



挑戦できる企業風土の実現

多様な個性・価値観を有する人財が、自立自走・連帯のもと、「創造と変革」に挑戦できる企業風土を醸成します。

キャリア形成と能力開発支援

従業員一人ひとりの持続的成長のために必要な教育・研修機会を提供し、キャリア形成と能力開発を支援します。

ダイバーシティの推進

「多様な人財の獲得」「公正な評価で報いる人事制度の構築」「効果的な人財配置を実現するタレントマネジメントシステムの充実」による、働き甲斐のある労働環境づくりに取り組みます。

従業員エンゲージメントの向上

多様な人財を受容する制度整備・意識変革を推進し、ワークライフバランスの充実による、従業員エンゲージメントの向上を実現します。

良好な社内環境の構築

従業員一人ひとりが心身ともに健康で、安全にいきいきと働き続けることができる良好な社内環境を構築します。

目標（2030年）

女性管理職比率

30%以上



男女賃金差異※

90%以上



男性育児休業取得率

85%以上



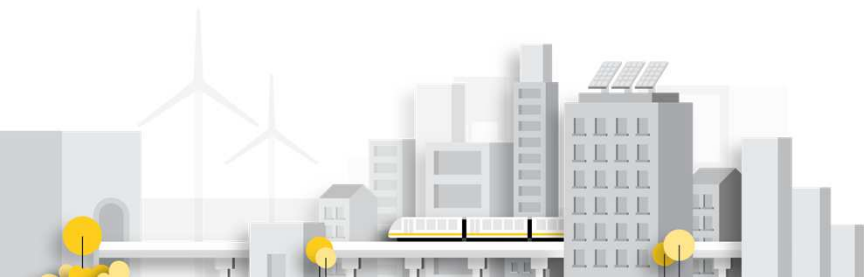
※男性従業員を100とした場合の女性従業員の賃金水準。

当社では賃金体系を職位により設定しており、性別による賃金格差でなく、同職位における男性、女性の賃金は同一です。
発生している格差は職位ごとの性別構成比の差に起因しています。

3

中期経営計画 Phase2

④ 持続可能な社会に向けて



当社グループは、「環境保全」に関する気候変動問題への対応として2030年の定性的目標に次の2つを掲げています。

- 社会の持続的な成長のため、地球環境問題に真摯に取り組む
- エネルギー使用の削減とネットゼロに向けての取り組みを実施

具体的に、
次のようにCO₂削減目標を
定め取り組んでいます。



2030年度までに

国内のScope1・2の総排出量

実質**50**%削減

(基準年度：2017年度)

Appendix



電子基板の高性能化、小型化・軽量化、通信伝送の超高速化、信頼性の向上を支える化学薬品を供給し、人々の豊かな暮らしを支えています。

当社の技術はさまざまな電子機器に貢献



通信基地局



サーバー・
スパコン



パソコン・
スマートフォン



ロボット



輸送機器



医療機器



ディスプレイ



メックのソリューション

電子基板の性能向上

銅と樹脂基板の
密着性向上

樹脂基板の
微細配線形成

銅の
表面の化学処理

高性能化

小型化・軽量化

省電力化

通信伝送高速化

信頼性向上

電子基板の用途が拡大するなか、市場のニーズをとらまえユニークな製品とサービスを提供しつづけ成長しています。

主に個人用端末で電子基板を使用

電子基板の用途が
社会インフラに拡大

売上高の推移

(百万円)

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

1965年5月

大阪市北区に
化学技術コンサルタント会社
としてスタート

1970年2月

電子基板用薬品製造に着手

パソコン用
半導体パッケージ基板向
け薬品が牽引

当社製品が世界で
使用されるようになった
1995年 CZシリーズ発売

電子機器の普及

インターネット
の普及

スマートフォン用基板、
電子部品向け薬品が牽引

5G/IoT/AI/
自動運転/DX/GX

'01/ナスダックジャパン上場

'22/東証再編により
プライム市場に移行

'03/東証2部上場

'07/東証1部指定

リーマンショック

ITバブル崩壊

COVID-19



「密着向上」「配線形成」「選択エッチング」の技術で、界面価値創造を実現します。

表面を粗化し、機械的に密着性を向上



表面を粗化せず、化学的に密着性を向上



配線を形成する



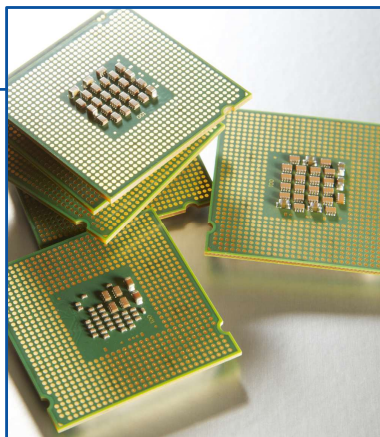
選択エッチング



独自の技術力により、世界で独占的シェアを確立

銅と樹脂の密着性を高める超粗化剤で、半導体パッケージ基板において世界市場における独占的シェアを確立。世界中の電子基板・部品メーカーなど、300社以上の顧客から評価・支持されています。

層間密着向上プロセスにおける世界的シェア



- 高い密着性と信頼性が認められ、先行してシェアを確保
- 30年以上の使用実績があり、CZ起因のエラーはゼロ
- 顧客ニーズや市場状況を把握し、継続的な製品改良を実施

界面価値創造

Creating and Fostering Value at Various Interfaces

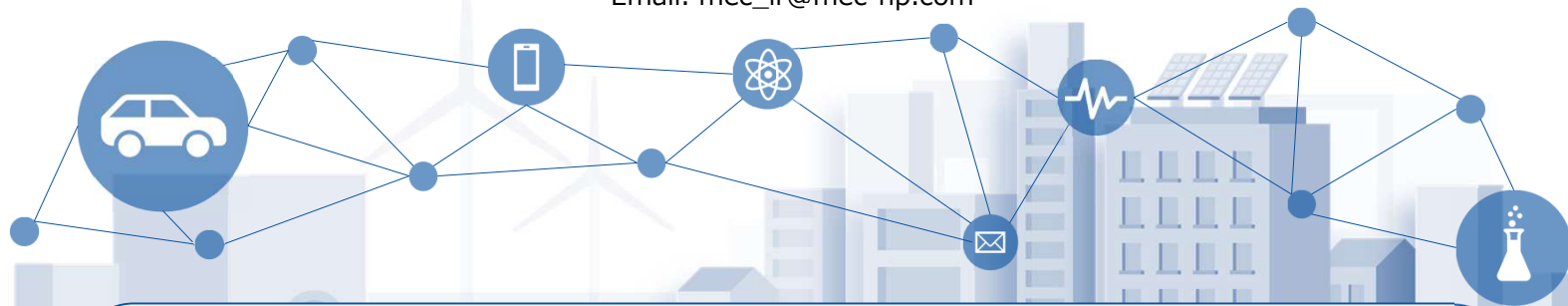


<https://www.mec-co.com/>

【連絡先】メック株式会社 コーポレートコミュニケーション室

Tel. 06-6401-8160

Email. mec_ir@mec-np.com



このプレゼンテーション資料には、2026年2月13日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知ください。